

< 삼성테크윈 채용 모집 분야 >

사업부	모집분야
신규사업	로봇, 바이오, 모터/인버터/드라이브
SS사업부 (Security Solution)	감시장비(카메라/DVR), SoC 설계, 시스템 Application, 로봇비전, 실물화상기, 지능형 감시·경계 로봇
IMS사업부 (Intelligent Machinery & Solution)	Chip Mounter
DIS사업부 (Digital & IT Solution)	휴대폰 카메라, DESIGN, Substrate(COF/PCB/LED), MODULE, 신소재
파워시스템사업부	엔진/에너지 장비
특수사업부	방산장비, 국방로봇

1) 신규사업(로봇, 바이오, 모터/인버터/드라이브)

분류	기술 내용
로봇	- Radar · 레이더 이동 표적 탐지/추적/인식 신호처리 알고리즘, 소프트웨어 관련 - Computer Vision · Geometry based Modeling, Detection & Tracking Algorithm, Machine Learning, Vision Sensor, Image Restoration - Communication · 영상 무선통신 및 암호화, C3I - 이동 로봇 · Sensor Interface : Radar, Laser Scanner, GPS & IMU · Perception : Localization and Mapping · Navigation : Mission/Path Planning, Vehicle Control - 제어시스템 · 전원보드 설계, 전자회로 설계, DSP 회로설계 및 응용, 모터 서보제어, 펌웨어 개발 - 기구시스템 · 로봇 기구 설계, 자동화장치 설계, 구조해석 - 통제 소프트웨어 · 시스템 설계, 개발 프로세스, 모델링 및 시뮬레이션, 네트워크 분석, Framework설계, User Interface 개발, 응용 프로그램 개발

분류	기술 내용
바이오	- 질병 진단 (Diagnostics) · Gene expression, 유전자, 단백질 마커 연구 - 진단시약 개발 (Kit Development) · PCR, RT-PCR, cloning, 핵산합성 및 유전자 서열 분석 - 분자 진단 장비 및 신뢰성 평가 · DNA, RNA 추출 및 검출기술 - 광신호 검출 · 조명/광학 설계, 스캔알고리즘, 광 신호 필터링 - 분자진단 분야 사업 및 상품기획 - xFDA 인허가(장비, 시약) 전문가
모터/ 인버터/ 드라이브	- 모터 설계 · Integrated Starter Generator, Traction Motor, Wheel-in Motor, AC/BLDC/Linear 전자기장 해석 및 설계 - 산업용 & 차량용 모터 제어 · 영구자석식 동기전동기(PMSM) 제어 · 모션제어(위치제어, 안정화제어, 속도/토크제어) - 산업용 & 차량용 전력전자 · 대용량 인버터/컨버터 설계, DSP 제어 설계 · 전력제어 Modeling & Simulation (PSIM, Matlab 등) · DSP 기반 AC/BLDC/Linear 모터제어용 모션제어기 설계 (DSP, FPGA 응용회로 및 제어 Firmware 설계) - 고속네트워크 기반 서보 드라이버 설계 · EtherCAT, Synqnet, Machtrolink, CC-Link, PWM 주파수 제어, 엔코더 제어 등

2) SS 사업부 : 감시장비(카메라/DVR), SoC 설계, 시스템 Application,
로봇비전, 실물화상기, 지능형 감시·경계 로봇

분류	기술 내용
기계	- 구조설계 (구동 메카니즘 설계, Body 구조설계) - 형상설계 (Cover 설계) - 기구해석 [유동해석(열/유체), 구조해석(소음/진동/피로)]
전기전자	- 디지털/아날로그 회로설계 · 아날로그 응용회로설계(영상/음성), 고속디지털회로설계, FPGA 설계(VHDL/VERILOG), 전원부 설계 - ASIC 설계(Architecture, RTL, FPGA, Front - end, SoC)
제어	- 제어계구조 설계 (모터 제어계 설계) - 제어알고리즘 설계 · Zoom/Focus 구동제어 알고리즘 설계
S/W	- OS 설계 (Embedded OS 설계) - Firmware 설계 (RISC CPU 제어설계, DSP 제어설계) - Application 소프트웨어 설계 · Windows/Linux Application 응용, Network Application 응용, Database Application 응용 - System 제어 설계 (Linux Device Driver 설계) - Module 제어 설계 (저장매체 제어기술, Serial 통신 응용) - 소프트웨어 구조설계 (데이터/시스템 구조설계)
Intelligence 알고리즘	- 지능형 기술 · 이동물체 탐지/추적, Camera Collaboration · 인식 알고리즘 설계, 얼굴 검출/검색 · Behavior Understanding
영상 음성	- 영상 압축복원 설계 (동영상처리 설계)
광학계	- 결상광학계 설계 (CCD/CMOS Lens) - 경통설계 (경통 구동계)
영상 센서부 제어	- 메가급 센서(CCD 및 CMOS) 및 열상센서 제어 · 센서 제어 주변부 회로 설계 · 센서 구동 알고리즘 S/W 설계

3) IMS사업부 : Chip Mounter

분류	기술 내용
기계	- 구조설계 (경량/강성화 설계, 구동 메커니즘 설계, 정밀 메커니즘 설계) - 형상설계 (Layout & Integration) - 요소설계 (동력전달장치 설계, 정밀 Motion Guide 설계) - 요소개발 (리니어 모터개발) - 유공압 응용 (유공압 제어기술) - 시험평가기술 (신뢰성 평가)
해석	- 해석기술 · 구조해석, Kinematic/Dynamic 해석, 진동/소음해석, 열해석, 유동해석
시스템/공정	- SMT 공정기술 (SMT In - Line 공정기술) - Packaging 공정기술 - FAB 공정기술 - 물류 자동화 설계/공정 기술 - 로봇 시스템 엔지니어링 (로봇 제어 포함) - 프린팅 공정기술 (Inkjet, Roll - to - Roll 등) - 검사 공정기술 (불량 검출/분류 알고리즘 포함)
전기전자	- 통신회로 설계 · 유선통신 회로설계, BUS 응용 설계(PCI, VME) - 디지털 아날로그 회로 설계 · 전장 설계, 내 노이즈 회로 설계, DSP 응용
제어	- 제어계 구조 설계 · 제어계 구조 설계, 모션 제어기 설계, 서보 앰프 설계 - 제어 알고리즘 설계

3) IMS사업부 : Chip Mounter

분류	기술 내용
광학계	- 결상광학계 설계 (CCD & CMOS Lens) - 조명광학계 응용 (광원, 조명계 렌즈) - Laser 광학계 응용 (정렬계)
S/W	- S/W구조 설계 (시스템 구조 설계, 데이터 구조 설계) - System 제어 설계 (실시간 Multitask 운용) - 제어 Sequence 설계, Device Driver 설계 - Application S/W 설계 · Window Application 응용, Network Application 응용, Database Application 응용, User I/F - 소프트웨어 Algorithm 설계 (최적화 알고리즘 설계) - 소프트웨어 Engineering (개발 절차 운용)
비전시스템	- 통합구조 설계 · 영상취득 H/W(Grabber) 응용, 비전, 광모듈 Application - 2D 비전 알고리즘 설계 · Pattern Matching 알고리즘 설계, 인식 알고리즘 설계 - 3D 비전 알고리즘 설계

4) DIS사업부 IT모듈사업 : 휴대폰 카메라

분류	기술 내용
회로설계	- 디지털/아날로그 회로설계 · 이미지센서 응용 회로설계, 저전력 회로설계, 고주파 회로 분석·평가 · 구동계 설계 (Motor Drive - IC 제어회로 설계) - 통신회로 설계 (유·무선 환경 시스템 네트워크 회로설계)
기계	- 렌즈 바렐 설계 (정밀 구동 제어 구조설계) - Actuator 설계 (구조해석, 초소형/저전력 구동원설계) - 방열 기구 설계 (열해석)
광학계	- 결상광학계 설계 (FF, AF, Zoom 광학계 설계) - 조명광학계 설계 (LED, 조명, 초소형 프로젝터 등)
영상음성	- Firmware 설계 (카메라시스템 제어 F/W 설계) - 영상 신호 처리 · 화질개선알고리즘, AE/AW B/AF, 패턴&모션 인식, 광학계 제어 알고리즘, 화질평가 프로그램

4) DIS사업부 DS사업 : DESIGN, Substrate(COF/PCB/LED), MODULE, 신소재

분류	기술 내용
Design	- 제품 설계 · Package/Substrate 설계 (회로, 구조, 방열 설계) · 연료전지 시스템 설계 (Stack, Flow Field Channel) · 지능형 센서/ 제어 모듈 설계 (H/W, S/W) - Simulation · Package/Module 구조 및 SI/PI/EMI 해석 · 재료 및 공정의 전기화학적 유동 해석 · PoF(Physics of Failure) 기반 신뢰성 해석 - Control & Inspection · 자동화 장비 설계 및 제어 알고리즘 개발

4) DIS사업부 DS사업 : DESIGN, Substrate(COF/PCB/LED), MODULE, 신소재

분류	기술 내용
Substrate	- 소재 · 물리적/화학적/기계적 특성 개선 · 신규 패키지에 적용 가능한 신소재 개발 - 표면 처리 · Surface finish 기술 (도금, 에칭, 전처리) · 용액 제어/ 관리 및 유기물 분석 - 공정 · Rigid 및 Flexible substrate 제작 · 공정 제어/ 관리/ 설계 · 설비, 기구 제어 및 설계
Module	- 센서 모듈 · 무기 박막 재료 전공자 · Sensor packaging 및 평가 기술 - Embedded 모듈 · Embedded Substrate 공정 개발 · Embedded 모듈 응용처 개발
신소재	- 투명 전극 소재 · Graphene 합성 및 기능성 소자 설계/제작 · 투명 전극 필름 소재 제작 및 평가 - 연료전지 · MCFC, SOFC 개발 - 신재생에너지 · 유기 태양전지 소재 개발

5) 파워시스템사업부 : 엔진/에너지 장비

분류	기술 내용
설계/해석	- 공력설계 (압축기, 터빈) - 추진/열역학/열전달/구조 설계 및 해석 - 소음 저감설계, 진동해석 및 평가 - 피로해석, 수명평가 및 신뢰성 설계 - 엔진/Layout 설계 및 상세설계 - 마찰학 (연료/윤활/베어링)
제어	- 제어 알고리즘 & 로직설계 (항공용/산업용 기기)
전기전자	- 전력제어회로 및 알고리즘 설계 (PCU & INVERTER) - 디지털/아날로그 회로설계 (항공/산업용 제어시스템)
해석	- 해석기술 · 압축기 공력해석 - 원심형 압축기 공력설계 및 해석 · 동특성 해석 - 에너지 장비류 장축 축진동 해석 · 열(Seal)해석 - DRY GAS SEAL 설계 및 제어
기계	- 시험평가기술 · 에너지 장비류 신뢰성 설계 및 신뢰성 시험/평가
시스템설계	- 프로젝트관리 · 가스압축기 개발 과제관리 (기술자문역)
소재 개발	- 재료기술 · 소재선정 기술, 수명평가 기술, 부식/방식 응용, 정밀주조 응용, 복합재료 응용, 재료 시험평가, 파손분석 기술, MR평가 기술

6) 특수사업부 : 방산장비, 국방로봇

분류	기술 내용
체계	- 체계 레이아웃 설계 - 차량 현수장치 설계 - 차량 동력전달장치 설계 - 동력장치 개발 (기계식/전자식) - 동력 - 신뢰성 시험평가
전기전자	- 디지털/아날로그 전기/전자 설계 - 항법장치/사격통제 장치 - EMI/EMC DSP 응용
제어	- 제어 알고리즘 설계 - 제어장치 HW/SW 설계 - 전력제어 설계 및 알고리즘 개발
CAE	- 열유체 해석 - 진동/소음 해석 - Hardware-In-the-Loop-Simulation (HILS)

8) MBA 부문

분류	기술 내용
MBA	- 마케팅/영업 - 회계/재무 - 기획 - 일반 경영관리 등
Techno-MBA	- 사업타당성 분석 및 사업진입 전략 수립 - 기술 확보 전략수립 및 도입 - 해외 기술선과 기술개발, 사업기획